

医疗设备技术需求确认表

设备名称	半自动病理切片机	总数量（台/套）	2	预算总金额（万元）	22
序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求			备注
*1	基本要求	用于病理科病理组织切片工作			
• 2	资质认证	具备CE认证			
3	技术和性能参数				
*3.1	切片厚度	（0.5—100）微米			
3.2	修片厚度	（1—600）微米			
3.3	样本夹头垂行程	≥70mm			
3.4	样本夹头水平行程	≥30mm			
3.5	样本夹头回缩	具备			
3.6	配重方式	铅块配重，非弹簧配重			
3.7	自动注油系统	具备自动注油系统			
• 3.8	修块模式	具备辅助修块模式			
3.9	粗调功能	可通过设备设计控制标本夹前进或后退的粗调功能			
3.10	样品角度可调整范围	具有零位显示，水平方向：±8°，垂直方向：±8°			
• 3.11	液晶屏显示	具备			
3.12	安全锁定功能	大手轮可最高点锁定和任意位置锁定			
3.13	报警及安全指标	手轮摇到极限值时出现设备提示音报警			
3.14	设备不良事件情况	厂家自报设备近三年不良事件情况			
*4	配置需求	主机 1台，刀架≥1个，包埋框标本夹头≥ 1个，废屑盘≥ 1个，相关附件1套			
5	售后条款				
*5.1	原厂保修年限	≥3年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日），未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。			

序号	技术和性能参数名称	招标参数和性能要求	备注
*5.2	零配件支持	提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供	
5.3	零配件保证供应时长	厂家自报	
5.4	到位维修响应	维修到达现场时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外）	
*5.5	保修期外维修费用	提供免费保修期外的年度整机保修费用价格，提供维修工时费计算方法及价格	
• 5.6	技术支持和服务网点	提供全国主要城市售后服务网点及售后人员数量	
• 5.7	升级与软件维护	保修期内免费升级和软件维护；保修期外，原软件维护仅收工时费	
• 5.8	专用工具、资料及其它	提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等）	
• 5.9	培训	提供使用培训和工程师原厂培训	
5.10	交货期	合同签订后3个月内交货	

备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。

2. 加注“•”号的技术指标为重要指标。

3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。